

第 55 回研究会

日 時： 平成 30 年 6 月 9 日（土）13:30～17:00

会 場： 同志社大学 寒梅館 2F 208 室

（詳細地図：<https://www.doshisha.ac.jp/information/campus/imadegawa/imadegawa.html>）

京都市営地下鉄今出川駅 2 番出口を出て，北へ徒歩 1 分，Tel. 075-251-3199)

プログラム

1. 講 演 13:30～17:00

(1) 海外廉価小型玉軸受の耐久性評価

東京理科大学

野口 昭治 氏

(2) 転がり軸受の極微量潤滑技術の研究

株式会社 ジェイテクト

松山 博樹 氏

山川 和芳 氏

谷本 清 氏

ストイメフ ボロ 氏

間野 洋嗣 氏

(3) EHD 接触における膜厚と破断率の同時測定—スクイズ膜の測定

日本精工株式会社

前田 成志 氏

丸山 泰右 氏

横浜国立大学

中野 健 氏

2. 技術交流会

会費：3,000 円

以上